

正本

檔 號：

保存年限：

國立中興大學 書函

機關地址：40227臺中市南區興大路145號

承辦人：鄭渝靜

聯絡電話：04-22840206-22

電子郵件：yccheng@nchu.edu.tw

受文者：材料科學與工程學系

發文日期：中華民國113年1月29日

發文字號：興國字第1130001833號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：

附件：

主旨：函轉日本台灣交流協會「2025年度日本台灣交流協會日本獎學金留學生(碩博士)」獎學金資訊，請協助公告周知，請查照。

說明：

一、旨揭獎學金相關資訊說明如下：

(一)資助對象：未滿35歲我國學生或研究者(社會人士亦可)，且計劃於114年4月、9月或10月進入日本各大學研究所(大學院)攻讀大學或專門學校時期所專修相關課程。

(二)申請條件：需先應考於臺灣舉辦之第一回日本留學試驗後再申請。

(三)報名截止日期：

1、第一回留學試驗：113年3月8日(星期五)。

2、赴日留學獎學金(碩博士)初試：113年6月28日(星期五)。

二、申請簡章、申請書等相關規定及資料，請詳該會官網：

<https://www.koryu.or.jp/tw/business/scholarship/longterm/>

。詳情請逕洽該協會台北事務所謝小姐，電話：

(02)2713-8000，分機2414。

正本：本校各學院、系、所、學位學程

副本：

國立中興大學

本案依分層負責規定授權單位主管決行

裝

言

線